中信证券股份有限公司 关于澜起科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")担任澜起科技股份有限公司(以下简称"公司"、"澜起科技")首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,负责澜起科技上市后的持续督导工作,并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	保存机构已与順起科技签订 承销 /2 保存
3	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海 证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后 在指定媒体上公告。	阑 起 科 技 在 本 持 续 督 导 期 间 未 发 生 按 有
4	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	澜起科技在本持续督导期间未发生关于 募集资金使用相关的违法违规或违背承 诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期 回访等方式,了解澜起科技募集资金使 用相关情况,对澜起科技开展持续督导 工作。
	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履 行其所做出的各项承诺。	守法律、法规、部门规章和上海证券で

序号	工作内容	实施情况
		用相关的的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保存机构督促澜起科技依照相关规定健全完善关于墓集资金使用相关的公司治
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度, 包括但不限于财务管理制度、会计核算 制度 和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	在本持续督导期间,澜起科技关于募集 资金使用相关的内控制度符合相关法规 要求并得到了有效执行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并 有充分理由确信上市公司向上海证券交易所 提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。	保荐机构督促澜起科技严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司 予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应 及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司 履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有 关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文 件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司 不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所 报告。	保荐机构对澜起科技的信息披露文件进 行了审阅,不存在应及时向上海证券交 易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	在本持续督导期间,澜起科技不存在控 股股东和实际控制人,澜起科技及其董 事、监事、高级管理人员未发生该等事
12.	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	在本持续督导期间,澜起科技小存在控 股股东和实际控制人, 澜起科技不存在
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	在本持续督导期间,经保荐机构核查, 澜起科技关于募集资金使用相关的事项 不存在应及时向上海证券交易所报告的
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说	

序号	工作内容	实施情况
	明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:	在本持续督导期间,澜起科技关于募集
	(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;	资金使用相关的事项未发生相关情况。
	(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业	
	意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗	
	漏等违法违规情形或其他不当情形; (三)公	
	司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条	
	规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;	
	(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告	
	的其他情形。	
	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确	
	现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。	
	上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保	
	荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15	
	日内进行专项现场核查: (一)存在重大财务	在本持续督导期间,澜起科技关于募集
15	造假嫌疑; (二)控股股东、实际控制人、董	资金使用相关的事项不存在需要专项现
	事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司	场检查的情形。
	利益; (三)可能存在重大违规担保; (四)	
	资金往来或者现金流存在重大异常; (五)上	
	海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现	
	场核查的其他事项。	

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

(一)核心竞争力风险

1、产品研发风险

集成电路产业发展日新月异,技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新,同时对市场进行精确的把握与判断,不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化,赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面: (1)公司新产品的开发存在 周期较长、资金投入较大的特点,在产品规划阶段,存在对市场需求判断失误的 风险,可能导致公司产品定位错误; (2)由于公司产品技术含量较高,公司存在 对企业自身实力判断失误的风险,主要是对公司技术开发能力的判断错误,导致 公司研发项目无法实现或周期延长; (3)由于先发性对于公司产品占据市场份额 起到较大的作用,若产品迭代期间,竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品,公司有可能丢失较大的市场份额,从而影响公司后续的发展。

针对上述潜在风险,一方面,公司将加强对行业新技术、新需求的动态跟踪,加强对市场需求的研判能力;另一方面,公司积极参与各类行业标准组织,参与甚至主导相关新产品标准的制定,从而降低后续产品研发风险。

2、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业,对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研,公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施,对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才,或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失,将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响,进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

针对上述潜在风险,一方面,公司为员工提供丰富的职业发展机会,让员工在企业中获得成长;另一方面,伴随着企业的发展壮大,合理提升员工待遇,实施股权激励在内的多种激励手段,从而吸引和留住优秀人才。

3、技术泄密风险

通过持续技术创新,公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来,公司就十分重视对核心技术的保密,及时将研发成果申请专利,并制定了严格完善的内控制度,保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密,或专利保护措施不力等原因,导致公司核心技术流失的风险。如前述情况发生,将在一定程度上削弱公司的技术优势,对公司的竞争力产生不利影响。

(二) 经营风险

1、客户集中风险

互连类芯片产品线是公司目前主要的利润来源,其中内存接口芯片产品的下游为 DRAM 市场,直接客户为内存模组厂商。根据相关行业统计数据,在 DRAM 市场三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名,市场占有率合计超过 90%,这导致公司在该产品线的客户集中度也相对较高。如果公司产品开发策略不符合

市场变化或不符合客户需求,则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系 老客户新增业务的可能,从而面临业绩下滑的风险。同时,由于客户相对集中度 高,如果发生客户要求大规模降价、竞争对手恶性竞争等竞争环境变化的情形,公司将面临市场份额波动、收入下滑的风险。

公司正积极研发和推广新产品,通过扩大产品种类,降低单一产品的客户集中风险。

2、供应商风险

公司为最大程度优化自身产能资源配置,同时考虑经济性原则,采取 Fabless 模式,将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来,公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系,外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研究和产品研发中去,以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外,晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业,因此相关行业集中度较高,是行业普遍现象。公司供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件,或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素,晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司需求,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。如果市场环境及供求关系发生变化,造成原材料价格上涨等情形,公司将面临成本上升、毛利率下降等相关经营风险。

3、津建®服务器平台业务波动的风险

服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分,也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。津逮®服务器平台技术壁垒高,市场门槛高,客户验证周期长,经过前期的市场推广和客户培育,报告期内公司的津逮®CPU 稳步发展,目前津逮®CPU 已经广泛应用于金融、政务、交通、数据中心等领域。但津逮®CPU 业务在其发展初期需求并不稳定,不排除因市场、政策、客户、产能等因素的影响而导致相关业务存在短期波动或不及预期。2023年,受宏观环境及行业去库存等因素影响,津逮®服务器平台产品线需求下降,

相关市场的需求恢复需要一个过程,相关产品线短期收入可能存在不确定性。

4、产品质量风险

公司采用 Fabless 的运营模式,专注于芯片的设计及研发环节,而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司的产品质量一方面取决于公司的研发设计水平,一方面取决于委外厂商的生产管理水平。如果公司产品设计出现缺陷,或委外厂商生产管理水平不足导致发生产品质量事故,将给公司造成直接经济损失,存在赔偿客户以及造成公司订单减少、收入下滑、盈利下降等风险。

5、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。2023 年,公司综合考虑库龄及市场价格等因素,对截至2023年12月31日的存货(主要为津建[®]CPU)进行了资产减值测试,计提存货跌价准备2.29亿元,计提后公司的存货账面价值为4.82亿元。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时,使得产品滞销、存货积压,将导致公司存货跌价风险进一步增加,对公司的盈利能力产生不利影响。

6、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业,该行业知识产权众多。在产品开发过程中,涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可,因此公司出于长期发展的战略考虑,一直坚持自主创新的研发战略,做好自身的知识产权的申报和保护,并在需要时购买必须的第三方知识产权,避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略,阻滞公司市场拓展的可能性。同时,也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

(三) 财务风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算,且发生的外币交易在初始确认时,按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额,但在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额,导致公司汇兑损益金额较大。

2023年,公司外汇汇兑收益为人民币232.46万元。由于人民币对美元汇率

的持续波动,公司存在汇兑损失的风险。

在所有其他变量保持不变的假设下,人民币兑美元汇率发生合理、可能的变动时,将对公司 2023 年净损益(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)产生的影响如下:

单位:元

假设	净损益增加/(减少)	
人民币对美元贬值 5%	12,801,758.18	
人民币对美元升值 5%	(12,801,758.18)	

(四) 行业风险

公司是集成电路设计企业,主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售,属于集成电路行业的上游环节。集成电路行业是资本及技术密集型行业,随着技术的更迭,行业本身呈现周期性波动的特点,并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势,将导致行业发生波动或需求减少,使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险,对经营情况造成一定的不利影响。

2023 年,受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的去库存影响,公司全年营业收入和净利润同比下滑。如果行业需求恢复进度缓慢,可能对公司短期经营业绩带来不确定性。

(五) 宏观环境风险

1、全球贸易摩擦风险

报告期内,公司的主要客户、供应商、EDA工具授权厂商大多为境外企业。 近年来,全球贸易摩擦频发,虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响, 但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业,如果全球贸易摩擦进一步升 级,有可能造成产业链上下游交易成本增加,下游需求受限,上游供给不畅,从 而将对公司的经营造成不利影响。

2022 年以来,美国出台一系列半导体出口管制政策,根据在此领域的专业 美国律师事务所的分析,截至目前相关规则对公司业务及相关人员均无直接影

响。如果相关半导体出口管制政策持续加码,不排除未来对公司业务及相关人员产生不利影响。公司将持续关注相关规则的更新并积极做好应对措施。

2、税收优惠政策风险

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)及《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件公告》(工业和信息化部公告 2021 年第 9 号)的规定,国家鼓励的集成电路设计企业,可自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,澜起电子科技(昆山)有限公司(以下简称"澜起昆山")符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准,可自 2022 年度起享受上述税收优惠,2023 年度减按 0%的适用税率缴纳企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生调整,或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件,则将对公司的经营业绩产生一定影响。

假设澜起昆山不再符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准,但仍属于高新技术企业,将适用 15%的企业所得税税率,则 2023 将增加 3,504.68 万元所得税费用,减少 3,504.68 万元净利润;假设澜起昆山不再符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准,且不属于高新技术企业,将适用 25%的企业所得税税率,则 2023 年将增加 5,841.13 万元所得税费用,减少 5,841.13 万元净利润。

四、重大违规事项

2023年,公司关于募集资金使用的情况不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度,公司主要财务数据与指标如下:

单位: 元人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,285,738,498.23	3,672,258,476.69	-37.76
归属于上市公司股东的净利润	450,909,813.13	1,299,378,059.37	-65.30

归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	369,932,113.14	883,144,528.39	-58.11
经营活动产生的现金流量净额	731,249,699.11	688,835,385.81	6.16
A > 1 Note 1 1 1			本期末比上年同期
主要会计数据	2023年末	2022年末	末增减(%)
主要会计数据 归属于上市公司股东的净资产	2023 年末 10,191,406,155.95		末增减(%)

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	1.15	-65.22
稀释每股收益(元/股)	0.40	1.15	-65.22
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.33	0.78	-57.69
加权平均净资产收益率(%)	4.44	14.18	减少9.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	3.64	9.64	减少6.00个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	29.83	15.34	增加14.49个百分点

2023 年,受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响,公司 DDR4 内存接口芯片与津逮[®]CPU 出货量较上年同期明显减少,因此,报告期内公司营业收入为 22.86 亿元,较上年同期下降 37.76%,归属于母公司所有者的净利润为 4.51 亿元,较上年同期下降 65.30%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3.70 亿元,较上年同期下降 58.11%。净利润下降的主要原因包括: (1)营业收入较上年同期减少 37.76%; (2)投资收益及公允价值变动收益总额较上年同期减少 4.62 亿元; (3)公司保持高强度研发投入,报告期内研发费用为 6.82 亿元,较上年同期增加 21.00%; (4)公司计提的资产减值损失为 1.93 亿元,较上年同期增加 1.66 亿元。

六、核心竞争力的变化情况

2023年,公司核心竞争力未发生重大变化,具体分析如下:

(一) 持续的创新研发能力与领先的技术优势

澜起自创立以来,持续专注于技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台,包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术,方案集成度高,可有

效提高系统能效和产品性能。

在内存接口技术领域,公司以技术创新为基础,发明了 DDR4 全缓冲"1+9"架构,最终被 JEDEC 国际标准采纳,该架构在 DDR5 世代演化为"1+10"框架,继续作为 LRDIMM 的国际标准。在 DDR5 世代,公司牵头制定 DDR5 内存接口芯片国际标准,巩固了公司在该领域的技术领先地位。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案,是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在该领域拥有重要话语权。经过持续不断的技术创新与积累,公司的核心技术在 DDR4 系列产品原有的基础上,建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术,研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台。在 DDR5 世代,澜起在内存接口芯片领域继续全球领跑,进一步巩固了在该领域的优势。2023 年 10 月,公司 DDR5 第三子代 RCD 芯片在业界率先试产。同时,公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案,是目前全球可提供全套解决方案的两家厂商之一。

在 PCIe 技术领域,澜起是全球领先的 PCIe 5.0/CXL 2.0Retimer 芯片供应商之一,公司自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于该产品中,自研 IP 带来了良好的整合性,在产品的时延、信道适应能力方面,公司具有一定的优势。公司是全球能够提供 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家厂商之一,也是全球能够提供 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片的两家厂商之一。

在 CXL 技术领域,公司提前进行战略布局,并于 2022 年 5 月发布全球首款 CXL 内存扩展控制器芯片 (MXC),相关技术处于国际领先水平。澜起已与全球 多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。2023 年 5 月,三星电子推出其 首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRAM,加速下一代存储器解决方案的商用化,公司的 MXC 芯片被用于该解决方案,是其中的核心控制芯片。2023 年 8 月,公司的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的几十项严苛测试,成为全球首家通过测试的内存扩展控制器产品,与国际知名 CPU、存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示,表明业界对公司技术实力的认可。目前,公司与主要内存模组、服务器系

统厂商的多个合作项目进展顺利,可为数据中心和云服务厂商提供灵活的解决方案,满足客户在数据库,AI训练等内存高带宽场景下的需求。

公司的核心技术基于自主知识产权,并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末,公司已获授权的国内外发明专利达 164 项。

(二) 领先的市场地位和品牌优势

经过 20 年的发展和积淀,澜起已成为国际知名的芯片设计公司,目前公司 核心产品内存接口芯片广泛应用于各类服务器,终端客户涵盖众多知名的国内外 互联网企业及服务器厂商,在全球内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位,实 现国内自主研发产品在该领域的突破。公司成立至今获得了多项荣誉,形成了独 特的品牌优势。2016年6月,中国电子学会认定公司"低功耗 DDR 系列内存缓 冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平";同年12月,该项技术及产 业化项目荣获"中国电子学会科学技术奖一等奖"; 2017年,公司荣获三星电子 颁发的"最佳供应商奖"; 2018年,公司产品"第二代 DDR4 内存缓冲控制器芯 片"荣获中国芯"年度重大创新突破产品"奖: 2018年11月, 津速®服务器 CPU 及其平台采用的"动态安全监控技术"获评第五届世界互联网大会"世界互联网 领先科技成果"; 2019年5月,公司"高性能 DDR 内存缓冲控制器芯片设计技 术项目"荣获上海市人民政府颁发的"上海市技术发明一等奖"; 2020年10月, 公司荣获"上海知识产权创新奖",公司的津建®CPU 荣获"中国芯年度重大创 新突破产品奖"; 2021年4月,公司 PCIe 4.0 Retimer 芯片荣获第九届"中国电 子信息博览会创新奖",同年,公司当选为工信部"制造业单项冠军示范企业"。 2022年4月,公司荣获"第二十三届中国专利优秀奖"。2022年11月,公司获 得全球领先的内存和存储厂商美光科技的肯定,荣膺美光科技"杰出性能奖(半 导体元器件)"和"杰出质量奖(封装&测试材料半导体元器件)"。2023年1月, 公司荣获"国家知识产权优势企业"。2023年11月,澜起荣登福布斯"2023中 国创新力企业 50 强"榜单。2023 年 11 月,公司再次斩获美光科技"杰出供应 商表现奖"。2023 年 12 月,公司荣获 SK 海力士"最佳供应商奖"。这一系列荣 誉的获得,充分显示出市场对于公司品牌的认可。

(三)全球化的产业布局

公司不仅扎根中国,还在美国、韩国等地建立了分支机构或办事处,派驻工程师及销售人员直接对接众多国际产业巨头,深入了解行业发展及技术水平变化趋势,亲身经历整个行业变更,把握瞬息万变的行业动态及创新方向,有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。同时通过全球化的产业布局,公司可以合理调配全产业资源,发挥产业协同效应,提高了公司的运营效率,有效地控制了成本。

(四)人才优势

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职, 并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博 士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士 (IEEE Fellow),积累了丰富 的设计、研发和管理经验,于 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖。杨博士在 2019 年成为全球微电子行业标准制定机构 JEDEC "杰出管理领袖奖"首位获奖 者,该奖为 JEDEC 组织新设立奖项,用于表彰推动和支持 JEDEC 标准发展的电 子行业最杰出的高级管理人士。2022年11月,杨博士被授予IEEE终身院士(IEEE Life Fellow)称号,以表彰他多年来在集成电路设计领域做出的杰出贡献。2023 年 12 月,杨博士荣获"安永企业家奖 2023 中国内地大奖"。公司总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就任该公司的工程研发总监, 拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。公司核心技术人员、研发部 负责人常仲元博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇,其中 3 篇发表于 ISSCC 会议,并作为第一作者出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。公司在 JEDEC 组织中的四个委员会及分会中安 排员工担任主席或副主席职位,成为细分领域国际行业标准制定的深入参与者。 公司入选全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会董事会,是三家入 选 JEDEC 董事会的中国企业之一。

公司核心团队多毕业于国内外著名高校,在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和

创新,目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术 人才。目前公司员工中约 77%为研发技术人员,且研发技术人员中约 67%拥有 硕士及以上学位,为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

(五) 显著的行业生态优势

公司深耕于服务器内存接口芯片市场,与全球主流的处理器供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商,建立了长期稳定的合作关系。自 2016年,公司携手英特尔、清华大学及国内知名服务器厂商,进一步开发津建[®]服务器平台产品,大力拓展数据中心产品市场。公司在芯片设计技术上长期积累,并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作,公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源,具备显著的行业生态优势。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发投入情况表

单位: 元

项目	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)
本期费用化研发投入	681,812,435.36	563,487,414.32	21.00
本期资本化研发投入	1	•	-
研发投入合计	681,812,435.36	563,487,414.32	21.00
研发投入总额占营业收入比例(%)	29.83	15.34	增加 14.49 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-
公司研发人员的数量 (人)	587	468	25.43
研发人员数量占公司总 人数的比例(%)	76.53	73.01	增加 3.52 个百分点

公司研发投入总额占营业收入比例增加 14.49 个百分点主要是随着布局的新产品越来越多,公司持续加大研发投入,且 2023 年实现营业收入 22.86 亿元,较上年同期下降 37.76% 所致。

(二)研发进展与研发成果

1、互连类芯片

I、DDR5 内存接口芯片

2023 年,公司 DDR5 第二子代 RCD 芯片开始规模出货,DDR5 第三子代 RCD 芯片在业界率先试产,同时开展 DDR5 第四子代 RCD 芯片的工程研发。

II、MRCD/MDB 芯片

2023年,基于客户对 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片工程样片的反馈意见,公司完成相关芯片量产版本的研发;同时开展第二子代 MRCD/MDB 芯片的工程研发。

Ⅲ. CKD 芯片

2023 年,基于客户对 DDR5 第一子代 CKD 芯片工程样片的反馈意见及标准更新,公司完成该芯片量产版本的研发。

IV. PCIe Retimer 芯片

2023 年,公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片成功量产,并持续推进 PCIe 6.0 Retimer 芯片关键 IP 的开发及验证工作。

V. MXC 芯片

2023年,基于客户对第一代 MXC 芯片工程样片的反馈意见及标准更新,公司完成该芯片量产版本的研发;同时开展第二代 MXC 芯片的工程研发。

VI. 时钟发生器芯片

2023 年,公司完成了时钟发生器芯片工程样片的流片并送样给主要客户,目前正在根据客户的反馈推进量产版本的研发。

2、津逮®服务器平台

2023年1月,公司正式发布第四代津速[®]CPU产品;2023年12月,公司正式发布第五代津速[®]CPU,旨在以多方面的性能优化应对AI、HPC、数据服务、网络/5G、存储等严苛工作负载的挑战。在保持产品竞争力的同时,公司还结合自身优势,持续致力于津速[®]生态系统建设。

3、AI 芯片

2023年,公司开展了第一代 AI 芯片工程样片的相关测试及验证工作,在相关应用平台进行业务适配,并陆续向潜在客户送样及收集反馈意见。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1128 号),公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元,募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元,上述资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"瑞华验字[2019]01500005 号"《验资报告》。

(二) 本期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 2,159,374,849.10 元投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目"),其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 1,944,172,582.98 元,2023 年度使用募集资金215,202,266.12 元。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为人民币 117,329,052.18 元,具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
2019年7月12日公司实际到账的募集资金	2,785,747,158.17
减:支付的其他发行费用	39,189,084.02
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减: 募投项目支出金额	2,098,368,911.50
减: 部分募投项目节余永久补充流动资金	666,830,595.20

加:募集资金理财产品累计收益金额	166,642,293.84
加: 累计利息收入扣除手续费金额	30,334,128.49
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额(含结构性存款)	117,329,052.18

注: 扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定,公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》; 2023 年度公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司不存在控股股东和实际控制人,报告期内,公司董事、监事、高级管理 人员及核心技术人员直接持有公司股份的变动情况如下:

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杨崇和	董事长、首席 执行官、核心 技术人员	780,000	1,380,000	600,000	限制性股票归属
Stephen Kuong-I o Tai	职工董事、总 经理	780,000	1,380,000	600,000	限制性股票归属
苏琳	副总经理兼财 务负责人	80,000	1,028,707	948,707	限制性股票归属 及间接持股转直 接持股所致
傅晓	董事会秘书	24,720	43,800	19,080	限制性股票归属
山岗	核心技术人员	40,000	70,000	30,000	限制性股票归属
常仲元	核心技术人员	30,000	60,000	30,000	限制性股票归属
史刚	核心技术人员	90,000	180,000	90,000	限制性股票归属

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股票均不存在质押或冻结情形,不存在违反减持承诺的情形。

十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具日,关于募集资金使用相关的情况不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人: 王建文

